

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202204634 U

(45) 授权公告日 2012. 04. 25

(21) 申请号 201120161499. 6

(22) 申请日 2011. 05. 19

(73) 专利权人 上海洛丁森工业自动化设备有限
公司

地址 201109 上海市闵行区园区北路 315 弄
118 号 4 幢 422 室

(72) 发明人 王徐坚 张曙 郝正宏 姚康

(51) Int. Cl.

G01L 13/06(2006. 01)

G01L 19/14(2006. 01)

G01L 1/00(2006. 01)

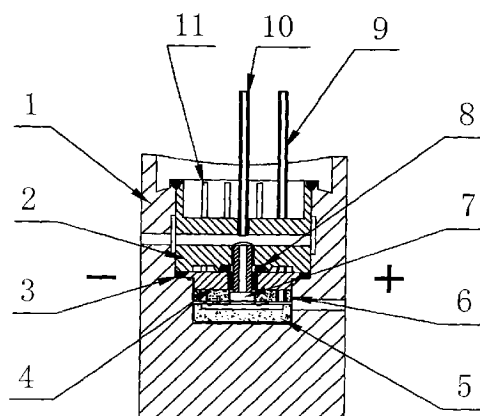
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种使用 T0 表压芯片支架的差压传感器

(57) 摘要

一种使用 T0 表压芯片支架的差压传感器,用 T0 表压芯片支架替代差压芯片支架, T0 表压芯片支架与电气连接片、差压传感器芯片以及顶盖封装,然后将封装后的 T0 表压芯片支架与差压传感器底座下端圆周电阻点焊密封,再在芯片支架背面负腔部分加装内、外密封圈和负腔密封顶块,同时该负腔密封顶块与差压传感器底座上端圆周焊接密封,这样就封装完成了一个使用 T0 表压芯片支架封装生产的差压传感器,提升了生产效率,降低了产品成本。



1. 一种使用 T0 表压芯片支架的差压传感器,整体从上至下包括差压传感器底座、负腔密封顶块、内密封圈、外密封圈、T0 表压芯片支架、电气连接底片、差压传感器芯片、顶盖,其特征是:带有电气连接片、差压传感器芯片和顶盖的 T0 表压芯片支架与差压传感器底座下端圆周电阻点焊密封,T0 表压芯片支架的背面装有内、外密封圈,并由负腔密封顶块顶紧密封,负腔密封顶块与差压传感器底座上端圆周焊接密封。

一种使用 T0 表压芯片支架的差压传感器

所属技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种差压测量装置,尤其是使用通用的 T0 表压芯片支架的差压传感器。

背景技术

[0002] 目前,公知的差压传感器是使用专用定制的差压芯片支架封装而成的,由于专用定制的芯片支架生产周期长,成本高,所以这样的结构设计不利于降低差压传感器的生产周期和成本。

发明内容

[0003] 为了克服现有的使用专用定制的差压芯片支架封装差压传感器产生的不足,本实用新型提供一种使用 T0 表压芯片支架的差压传感器。对差压传感器的整体结构进行调整设计后,便可以将 T0 表压芯片支架应用到差压传感器的封装生产,从而缩短了差压传感器的生产周期并且降低了成本。

[0004] 本实用新型解决问题所采用的技术方案是:用 T0 表压芯片支架替代差压芯片支架,使差压传感器结构从上至下包括差压传感器底座、负腔密封顶块、内密封圈、外密封圈、T0 表压芯片支架、电气连接底片、差压传感器芯片、顶盖,其中,T0 表压芯片支架与电气连接片、差压传感器芯片及顶盖封装,然后将封装后的芯片支架与差压传感器底座下端圆周电阻点焊密封,再在芯片支架背面负腔部分加装内、外密封圈和负腔密封顶块,同时该负腔密封顶块与差压传感器底座上端圆周焊接密封,这样就完成了一个使用 T0 表压芯片支架封装生产的差压传感器。

[0005] 本实用新型的有益效果是,这种使用通用的 T0 表压芯片支架封装生产差压传感器的方法,提升了生产效率,降低了产品成本。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的结构原理图。

[0008] 图中 1. 差压传感器底座,2. 负腔密封顶块,3. 外密封圈,4. T0 表压芯片支架,5. 顶盖,6. 电气连接片,7. 差压传感器芯片,8. 内密封圈,9. T0 表压芯片支架导油管,10. 顶块负腔导油管,11. 支架电气连接引脚。

具体实施方式

[0009] 在图 1 中,T0 表压芯片支架(4)与电气连接片(6)、差压传感器芯片(7)以及顶盖(5)封装后通过圆周电阻点焊的方式焊接密封到差压传感器底座(1)下端,在 T0 表压芯片支架(4)背面负腔处装上内密封圈(8)和外密封圈(3),再装入负腔密封顶块(2)顶紧,然后在负腔密封顶块(2)背面与差压传感器底座(1)上端四周焊接密封,通过 T0 表压芯片支

架 (4) 上的 T0 表压芯片支架导油管 (9) 向差压传感器底座 (1) 正腔充灌硅油, 通过负腔密封顶块 (2) 上的顶块负腔导油管 (10) 向差压传感器底座 (1) 负腔充灌硅油, 将导油管密封后便可以通过 T0 表压芯片支架 (4) 上的支架电气连接引脚 (11) 传导电信号输出, 差压传感器封装完成。

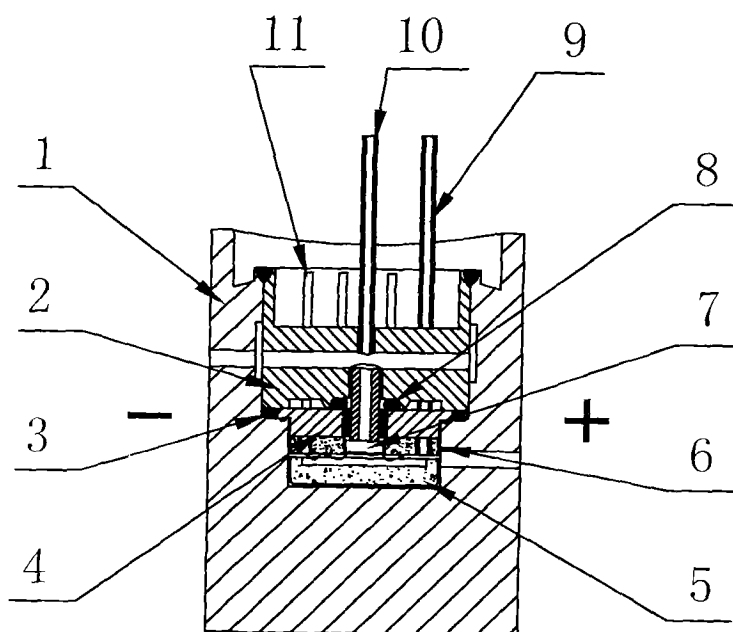


图 1